（上接B064版）

3、发行对象及认购方式

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、本次发行决议的有效期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

若法律、行政法规、规范性文件以及部门规章对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、募集资金规模及用途

本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体晶圆制造及封测项目 | 39,726.25 | 21,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | | 48,726.25 | 30,000.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票的预案》。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票的预案》。

四、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，充分论证了本次向特定对象发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据，方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

五、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了研究和分析，并编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-033）和《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）等相关文件及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，公司制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》，有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票方案及实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码：688079　证券简称：美迪凯　公告编号：2023-033

# 杭州美迪凯光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,033.3334万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金102,239.67万元，坐扣承销和保荐费用5,996.18万元（其中不含税承销费为5,656.78万元，该部分属于发行费用；税款为339.41万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为96,582.89万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,376.37万元后，公司本次募集资金净额为94,206.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕77号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年6月30日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行 | 33050161772709899999 | 35,101.16 | 420.95 | |
| 中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行 | 8110801018779999999 | 61,142.32 | | 已注销 |
| 杭州银行科技支行 | 3301040160017089403 | | | 已注销 |
| 宁波银行杭州城东支行 | 71060122000511992 | | | 已注销 |
| 宁波银行杭州城东支行 | 71060122000512468 | | 2.97 | |
| 合 计 | | 96,243.48 | 423.92 | |

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,036.96万元，系未扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及承销费税款

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2022年11月4日，除部分待付合同尾款外，公司研发中心建设项目已完成建设并投入使用。经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金5,921.62万元(包含截至2022年11月4日的账户余额5,907.83万元，及收到的银行利息收入13.79万元)永久补充流动资金。

截至2023年6月30日，光学光电子元器件生产基地建设项目累计投入募集资金金额已超过拟投入募集资金金额，主要原因系公司以部分闲置募集资金投资取得的收益、利息收入。该项目结余募集资金18.88万元，均系收到的银行利息收入，其中15.91万元已永久补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2023年6月30日，公司存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%的情况，情况说明详见本报告附件2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2021年3月8日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超12个月。截至2022年3月7日，公司已将暂时补充流动资金的款项10,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2022年3月8日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月7日，公司已将暂时补充流动资金的款项7,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2023年3月10日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，本公司实际运用闲置募集资金1,700.00万元暂时补充流动资金。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2021年3月8日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币65,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买委托理财产品尚未到期的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2021年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2021年5月18日经股东大会审议通过。

2022年4月21日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2022年5月13日经股东大会审议通过。

截至2022年11月4日，除部分待付合同尾款外，公司研发中心建设项目已完成建设并投入使用。经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金5,921.62万元(包含收到的银行利息收入)永久补充流动资金。

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2023年5月19日经股东大会审议通过。

截至2024年6月30日，光学光电子元器件生产基地建设项目累计投入募集资金金额已超过拟投入募集资金金额，主要原因系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致，尚未使用募集资金金额系以部分闲置募集资金投资取得的收益、利息收入。该项目结余募集资金18.88万元，均系收到的银行利息收入，其中15.91万元已永久补充流动资金。

截至2023年6月30日，公司累计使用节余募集资金（超募资金）永久补流金额为21,837.53万元，尚未使用完毕的前次募集资金金额为2,123.92万元（包含暂时补充流动资金的募集资金1,700.00万元），未使用金额及占前次募集资金总额的比例为2.25%，主要系尚未使用完毕的超募资金，公司拟将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年8月12日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：94,206.52 | | | | | | | | | 已累计使用募集资金总额：93,799.87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额：5,937.53 | | | | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | |
| 变更用途的募集资金总额比例：6.19%[注1] | | | | | | | | | 2021年：51,735.88 | |
| | | | | | | | | | 2022年：36,693.97 | |
| | | | | | | | | | 2023年：5,370.02 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 光学光电子元器件生产基地建设项目 | 光学光电子元器件生产基地建设项目 | 61,142.32 | 61,142.32 | 62,312.00 | 61,142.32 | 61,142.32 | 62,312.00 | 1,169.68 [注2] | 2023.1 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 15,285.01 | 15,285.01 | 9,650.34 | 15,285.01 | 15,285.01 | 9,650.34 | -5,634.67 [注3] | 2022.7 |
| 3 | 超募资金 | 超募资金 | 17,779.19 | 17,779.19 | 15,900.00 | 17,779.19 | 17,779.19 | 15,900.00 | -1,879.19 | 不适用 |
| 4 | 项目结余资金补充流动资金 | 项目结余资金补充流动资金 | | | 5,937.53 | | | 5,937.53 | 5,937.53 | 不适用 |

[注1]变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额（包含募集资金的投资收益及利息）/（募集资金总额+募集资金的投资收益及利息）

[注2]主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致；该项目结余募集资金18.88万元，均系收到的银行利息收入，其中15.91万元已永久补充流动资金

[注3]公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司将研发中心建设项目予以结项，并将节余募集资金5,921.62万元(包含收到的银行利息收入)永久补充流动资金

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | | |
| 1 | 光学光电子元器件生产基地建设项目 | 31.47% | [注1] | | | -868.5 | -868.5 | [注1] |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注2] |
| 3 | 超募资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 项目结余资金补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

[注1]截至2023年6月30日，该项目累计承诺效益为1,742.44万元，累计实现效益-868.50万元，该项目未达到承诺效益的主要原因系投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目规模效益未能及时体现

[注2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

# 杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合实际情况，公司董事会制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”），具体情况如下：

一、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

三、未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划

（一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配形式及期间

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

根据公司经营情况，公司每一会计年度可进行一次股利分配，通常可由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由董事会提出并经临时股东大会审议。

（三）现金分红的条件和比例

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

前款“特殊情况”是指下列情况之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计净资产40%；

2、公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产10%或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产30%；

3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

4、分红年度资产负债率超过70%或者经营净现金流量为负数；

5、公司预计未来十二个月出现可动用资金少于公司最近一年经审计营业收入10%的情形，并可能导致无法正常支付员工薪酬和维持基本运营；

6、公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。

（四）现金分红政策

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

前款“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（包括10%）的事项。

（五）股票股利分配条件

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

四、利润分配决策、调整机制

（一）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会二分之一以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

（二）利润分配政策调整的原则

公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

五、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

（一）股东分红回报规划的制定周期

公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不需另行制定三年股东分红回报规划。

（二）股东分红回报规划调整的决策机制

公司应当严格执行现金分红政策及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或者变更，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整或者变更的理由，形成书面论证报告，履行相应的决策程序并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

六、公司利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分配预案和现金分红政策制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码：688079　证券简称：美迪凯

# 杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告

二〇二三年八月

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”或“公司”）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、集成电路产业发展已成为国家重点战略

自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场方面相关政策。2014年6月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出“到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小”、“到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展”的奋斗目标。2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域，明确提出要着力提升集成电路设计水平。2020年3月，工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》，持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。2020年7月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。2021年11月，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出丰富5G芯片、终端、模组、网关等产品种类，加快智能产品推广，扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。

目前中国集成电路核心技术受制于人的现状还没有根本改变，公司本次募集资金投资项目拟生产的射频前端芯片等产品仍主要依赖进口，严重影响了产业的转型升级和国家安全。公司本次募集资金拟投资半导体晶圆制造及封测项目，该项目主要生产射频前端芯片等产品，符合国家重点发展集成电路的产业政策。

2、射频前端芯片应用领域广泛，市场空间广阔

射频前端芯片属于集成电路中的模拟芯片，作为无线连接的核心，是实现无线信号发送和接收的必需器件，其功能直接决定了终端可以支持的通信制式，其性能决定了终端的通信速率、接收信号强度、通话稳定性等重要通信指标，在模拟芯片中属于进入门槛较高、设计难度较大的细分领域。射频前端芯片具体包括天线调谐器（Tuner）、天线开关（Switch）、滤波器（Filter）、功率放大器（PA）和低噪声放大器（LNA）等。

射频前端芯片在手机蜂窝通信、Wi-Fi通信、蓝牙通信、ZigBee等无线通信领域均得到广泛使用。因不同通信领域涉及的无线频段、带宽、应用终端场景等存在差异，所对应的射频前端芯片在技术特征、材料及工艺等方面也存在一定差异。通信技术的每一次迭代升级，如4G向5G的发展、Wi-Fi5向Wi-Fi6的发展，都需要射频前端芯片同步升级作为硬件支撑。根据Yole Development数据，2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元，具有广阔的市场前景。

3、公司已经掌握了射频前端芯片制造的核心工艺，具备丰富的行业业务资源

公司在精密光学、半导体光学、半导体封测等领域深耕多年，积累了丰富的制造经验及行业资源。

在工艺和制造方面，公司通过对超薄屏下指纹芯片集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案的开发，已具备了直接在半导体晶圆上叠加各种光学成像传输所需的整套光路层技术，拥有多项核心技术及系统级光学解决方案的能力。射频前端芯片的制造工艺和半导体光学制造工艺存在较大的相似性，主要制造流程均包含涂胶、曝光、显影、镀膜、去胶剥离（lift-off）、干刻等流程，最终在晶圆上形成数层电路或光路的结构。部分工艺环节中，半导体光学的制造工艺比射频前端芯片制造工艺要求更高、难度更大，如在去胶剥离（lift-off）环节，半导体光学使用的是介质膜，成膜温度较高，对光刻胶耐高温要求极高，且成膜角度较小，存在膜包胶的现象，去胶剥离难度大，技术要求高；而射频前端芯片使用的是金属膜，成膜温度低，成膜角度较大，去胶剥离难度较小，技术要求相对较低。此外，公司半导体光学制造的晶圆尺寸，相较于射频前端芯片更大，对整个工艺流程的均匀性要求更高。在曝光和镀膜环节，射频前端芯片对于线宽及成膜厚度等加工工艺精度要求相较半导体光学更高，针对该部分工艺，公司已投入大量的资金和研发人员，已形成了一定的科技成果，在该领域已申请多项专利，已掌握了相关工艺技术。综上所述，基于半导体光学制造的长期积累，公司已掌握射频前端芯片制造的核心工艺。目前，公司已利用现有生产设备完成了射频前端芯片的小批量生产。

在终端行业资源方面，公司已有的精密光学、半导体光学、半导体封测领域产品主要应用于通信和消费电子、人工智能、物联网、新能源汽车等领域，同时，公司本次募投项目生产的主要产品射频前端芯片也主要应用于前述领域，面向相似的终端市场，公司在此领域已经积累了丰富